



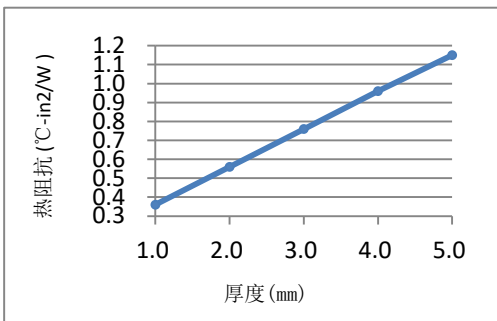
特性

- 》良好的热传导率 : 3.5 W/mK
- 》双组份材料, 易于储存
- 》优异的高低温机械性能及化学稳定性
- 》适用于低压力环境
- 》可依温度调整固化时间
- 》可用自动化设备调整厚度

应用

- 》计算器硬设备
- 》通信设备
- 》汽车用电子设备
- 》导热减震设备
- 》散热片及半导体

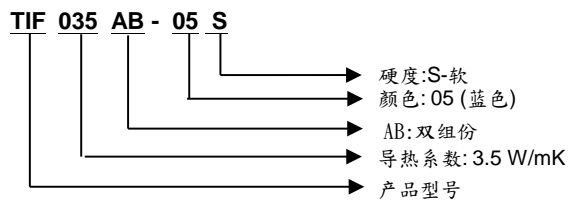
热阻抗



TIF™ 035AB-05S是一种高导热、液态间隙填充材料, 具有双组份及不同温度固化时间特点。它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上, 因而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。以液态方式, 提供各种厚度, 取代一般导热垫片的模切厚度, 且不同于一般硅胶片, 此系列产品固化后是干燥可触摸的, 故可被更广泛应用。

TIF™035AB-05S系列特性表		
未固化材料特性		
性质	数值	测试方法
颜色 (A组份)	白色	目视
颜色 (B组份)	蓝色	目视
混合粘度	1500,000 cps	GB/T 10247
密度	3.1 g/cc	ASTM D792
混合比例	1:1	*****
保质期25°C	6个月	*****
固化条件		
操作时间25°C (分钟)	30 分钟	*****
固化时间25°C (分钟)	60 分钟	*****
固化时间100°C (分钟)	30 分钟	*****
固化后材料性能		
颜色	蓝色	目视
硬度	45 Shore 00	ASTM D2240
工作温度	-45 ~ 200°C	*****
耐电压强度	200 V/mil	ASTM D149
介电常数	4.6 MHz	ASTM D150
体积电阻率	10 ¹² Ohm-meter	ASTM D257
阻燃等级	94 V0	E331100
导热系数	3.5 W/mk	ISO22007-2
比热容	2.2 MJ/m³K	ISO22007-2

产品型号说明



导热介面材料
应用技术下载



<http://www.ziitek.com>

产品规格

50 cc/支, 48 支/箱; 400 cc/支, 9 支/箱
或在注射器用于自动化应用定制包装。

如欲了解不同规格产品信息请与本公司联系。

<p>导热材料</p> <p>加拿大: Tel: +001-604-2998559 E-mail: sales@thermazig.com</p>	<p>导热工程塑料</p>	<p>发热材料</p> <p>中国: Tel: +86-769-38801208 E-mail: frances@ziitek.com.tw</p>	<p>屏蔽材料</p>	<p>发泡硅胶</p> <p>台湾: Tel: +886-2-22771007 E-mail: frances@ziitek.com.tw</p>	<p>模切制品</p>
--	----------------------	---	--------------------	--	--------------------